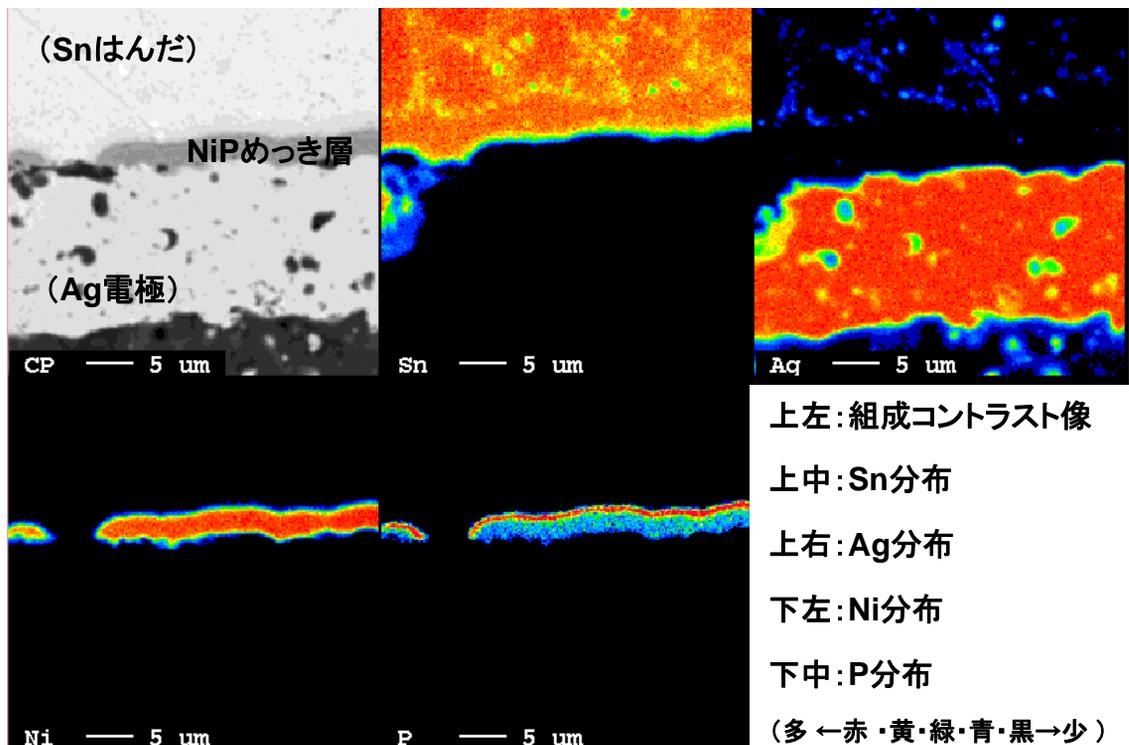


半導体めっき層の元素分布分析



＜分析手法＞EPMA* (電子線マイクロアナライザ)による
樹脂埋込研磨断面の元素分布分析

密着強度が弱いAg電極とSnはんだ界面を調べたところ、
電極上に形成されたNiPめっき層のSn側表面にP(燐)が
偏析していることが分かりました。この偏析により密着強度
が弱くなったことが推定されます。



元素分布分析(元素マッピング分析)結果

* EPMA: Electron Probe Micro Analyzer